

深圳丹邦科技股份有限公司
关于化学法电子级特种聚酰亚胺厚膜达到可工业化生产条件的
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“丹邦科技”）全资子公司广东丹邦科技有限公司（以下简称“广东丹邦”）的化学法电子级特种聚酰亚胺厚膜，以多重结构倾斜苯环单体为原料，在零下 100℃进行预聚，并对经架桥反应形成的多重倾斜相嵌结构进行掺杂、杂化及离子交换，最后通过化学法、喷涂法及口井式加热工艺，获取大面积大宽幅（1640mm/1800mm）化学法微电子级聚酰亚胺厚膜（130μm/140μm/150μm/160μm/170μm）的工业化技术。该技术为公司自主知识产权技术并申请/获得相关专利（专利申请/授权号：201910055344.5、201811324383.2、201811308540.0、ZL 201310144111.5、ZL 201310144099.8）。产品具有优异的尺寸稳定性、低热膨胀系数，其主要性能指标有：（1）成膜厚度×宽度：（130μm/140μm/150μm/160μm/170μm）×（1640mm/1800mm）；（2）热膨胀系数≤25ppm/℃；（3）体积电阻率≥ $4.5 \times 10^{16} \Omega \cdot \text{cm}$ ；（4）拉伸强度≥110MPa；（5）热收缩率≤-0.01%。以上指标通过第三方安普检测测试，能够满足行业标准的要求，目前是首家在全球推出的新产品，产品已经科学技术部西南信息中心查新中心出具的科技查新报告（查新报告编号：J20185001210448005）表明：“所述开发喷涂-口井式加热工艺生产高性能大宽幅 PI 厚膜技术，实现大宽幅 PI 厚膜（厚度 120-180μm×宽度 1640 mm/1800 mm×长度 1000m+）的大面积、卷到卷（R-R）式批量生产，在所检文献以及时限范围内，国内外未见文献报道。”

结合上述公司已实现的自主知识产权技术，后续公司将视情况开展工业化生产，工业化后预计将对公司的生产经营和业绩产生正向的影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月 28 日